

# 半導體工程系-110學年度入學管道與員額



部別	學制	招生總額(名)	班級數
日間部	四技	164	三班
	研究所	20	一班
進修部	四技	55	一班
	碩士在職專班	12	一班

## 日間部四技-入學管道與員額(共164名)

技優甄審(50名) 微電子應用技優領航專班	外加50 本專班於三年級上學期分組：人機介面系統整合組(25名)、鐵道機電整合組(25名)
甄選入學(53名)	內含26(含青儲組1)、外加27(原住民1、AI半導體領域-擴充26)
聯合登記分發(53名)	內含24、外加29(原住民1、退伍軍人1、僑生1、境外子女1、蒙藏生1、政府外派子女1、AI半導體領域-擴充23)
高中生申請入學(4名)	外加4
技職繁星(4名)	外加4



Department of  
Microelectronics Engineering  
半導體工程系